

## MI bond

セラミック砥粒専用汎用ボンド

ロールプロフィール研削盤

## ■製品/加エイメージ



準備中

## ■砥石仕様

形状 / 寸法 / 周速	平型	150	×	---	×	---	34 m/s
現行品	LCA5W	60/80	M	7	V	MI	---
ご提案品	LCA5W	60/80	L+	8	V	MI	---

## ■研削条件

研削盤 / 方式	プロフィール研削盤	/	トラバース
加工物 / 寸法	ロール	/	---
被削材 / 硬度	ハイス鋼	/	HRC64~66
取り代 / 面粗度	5mm	/	---
ドレス理由	研削焼け	/	---

## ■加工結果

- ・砥粒率を下げ、被削材に対し喰いつき易い状態にすることで、研削焼けを抑制
- ・結合度を下げること、目つぶれによる抵抗値上昇を抑制